

广州方邦电子股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购境内某公司持有的挠性覆铜板及相关资产组（以下简称“标的资产”）的重大事项，预计交易金额为人民币 1.4 亿—1.6 亿元（不含税），具体金额在进一步洽谈中。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

标的资产位于境内，若公司成功收购标的资产，预计短期内不会对公司经营利润产生重大影响，但该标的资产与公司的产品项目有较好的战略协同发展效应，有利于公司进一步完善产品布局、拓展销售渠道、优化人才团队结构，加快公司发展速度。

目前该收购事项尚处于谈判阶段，最终能否实施，存在一定的不确定性。鉴于标的资产具有一定规模，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计交易将构成重大资产重组；本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更；前述交易不构成关联交易事项。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次重大资产重组的进展情况

2021 年 1 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，公司及有关各方正在积极推进本次交易，中介服务机构的尽职调查工作正在有序进行。

截至本公告日，中介机构尽职调查工作已接近尾声，交易方案尚在协商。

三、风险提示

因交易各方尚未就交易方案达成一致意见，本次重大资产重组存在终止的可能性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次重大资产重组事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021年2月23日